

2009年7月15日

各位

兼松株式会社

下記のとおり、人事異動および組織改編を行いますので、お知らせします。

1. 人事異動

(8月1日付：デバイスカンパニー)

新 職	現 職 (前 職)	氏 名
カンパニープレジデント補佐	〔モジュール&デバイス本部〕 副 本 部 長	しまだ たけずみ 島田 武純
半 導 体 第 一 部 長	〔セミコンダクター部品本部〕 副 本 部 長	の だ あきら 野田 彰
半 導 体 第 二 部 長	〔セミコンダクター部品本部〕 特 機 営 業 部 長	おおくら たかあき 大倉 隆明
システム機器部長	〔セミコンダクター部品本部〕 東 日 本 営 業 部 長	しまだ ひろゆき 島田 弘幸
部品・材料第一部長	〔モジュール&デバイス本部〕 キーデバイス第一部長	ふかきわ はじめ 深沢 始
部品・材料第二部長	〔モジュール&デバイス本部〕 キーデバイス第二部長	あきば てっぺい 浅羽 鉄平

(9月1日付)

新 職	現 職 (前 職)	氏 名
兼 松 米 国 会 社 ヒューストン支店長	〔鉄 鋼 貿 易 部〕 第 五 課 長	やまだ りょう 山田 亮

2. 組織改編

(8月1日付：デバイスカンパニー)

現行の2本部制（セミコンダクター部品本部、モジュール&デバイス本部）を廃止し、17部・室・支店を、半導体第一部、半導体第二部、システム機器部、部品・材料第一部、部品・材料第二部、デバイス統括室の6部・室に再編いたします。

以 上

【お問い合わせ先】
兼松株式会社 広報室
TEL:03-5440-8000